

電路板製作資料清單

請購連絡人: <u>吳昆達</u> 部門: <u>M000</u>	日期: <u>115</u> 年 <u>8</u> 月 <u>14</u> 日	請購單編號: _____
電話: <u>03-5912129</u> 傳真: _____		

製作規格:

- 1.板號: SNM_H- V3-260813 (Gerber)
- 2.層數: 6 Layer
- 3.電路板尺寸: 35 MM X 54 MM (單片尺寸----- 0片併板)
- 4.銅箔厚度: 0.5 盎司 / 平方呎 (外層:0.3~0.5 oz 內層: 0.5 oz) 依疊構計算為主
- 5.電路板厚度: 1.0 MM ± 0.1 MM 疊構參考下圖
- 6.板材: ☒ FR-4 ☐ BT ☐ PI ☐ FR-4補強
- 7.表面處理: ☒ 噴錫 , ☐ 鍍金 , ☐ OSP(Entek) ☐ 鍍銀
- 8.數量: 40 PCS
- 9.預訂完成日期: 115 年 月 日.
- 10.表面防焊 ☐ 琥珀 ☐ 透明 ☒ 綠 ☐ 黑

交付資料:

☒ Gerber File, 檔名 : SNM_H-251105(Gerber).zip

☒ Master Drawing主圖 ,參考 _____ 內之檔案

製作完成後,請歸還所有資料

備註:

1. O/S TEST : YES , ☐單面 ☒雙面
- 2.金手指: NO
- 3.鍍金厚度: NO
- 4.阻抗控制: YES 5mil 50ohm
- 5.AOI 測試: YES
6. BGA Substrate 特殊製程: NO
7. V-VUT: NO
8. 併板: NO
9. 排連片加版邊: YES
10. 盲埋孔/樹塞: YES , ☒1階 ☐2階

PCB Stack Up				Impedance			
Layer	Type	Thickness (mil)		Single ended	OHM	differential	OHM
Top side solder mask		0.50 mils					
L1	TOP	copper+plating	1.40 mils	5	50	5/5	90
		3.00 mils					
L2	GND	copper	1.40 mils				
		3.00 mils					
L3	M1	copper	1.40 mils				
		18.00 mils					
L4	M2	copper	1.40 mils				
		3.00 mils					
L5	VCC	copper	1.40 mils				
		3.00 mils					
L6	Bottom	copper+plating	1.40 mils	5	50	5/5	90
Bottom side solder mask		0.50 mils					
TOTAL		39.40 mils					
		1.00 mm					

收件廠商: _____ 簽收人: _____ 日期: _____

(請收件廠商簽收後傳回連絡人處!)

1. 本表單以板號作為資料之識別。
2. 本所所提供之技術資料,屬於本所之智慧財產權,僅限貴公司承製本案使用,用畢後應歸還本所,貴公司非經本所之書面許可,不得任意複製、使用、轉移、作為其他用途或移轉給第三者。
- 3.